

# 2024半导体制造封装材料展 | 碳化硅半导体材料与电子元器件展-半导体展会

产品名称	2024半导体制造封装材料展   碳化硅半导体材料与电子元器件展-半导体展会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	1980.00/平方米
规格参数	半导体展:国际展
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

## 产品详情

### SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日

展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

SEMI-e 深圳半导体展深耕半导体行业领域，关注产业核心技术和发展趋势，通过搭建高端的产业生态交流平台，为粤港澳大湾区构建具有国际竞争力的现代产业体系贡献力量。

芯片计划办公室正准备提供390亿美元的赠款以及750亿美元的贷款和贷款担保，将禁止赢得这笔资金的公司大幅增加其在中国的产量或扩大其实体制造空间。先进芯片的涨幅将被限制为5%，而28nm或更成熟的旧技术的涨幅将被限制为10%。

“美国芯片从根本上来说是一项国家安全倡议，这些护栏将有助于确保接受美国政府资金的公司不会损害我们的国家安全，因为我们将继续与我们的盟友和合作伙伴协调，以加强全球供应链并增强我们的集体安全。”美国商务部长吉娜·雷蒙多在一份声明中表示。

美国商务部取消了初提议条款中的严格限制。此前，该机构对中国先进产能的投资设定了10万美元的支出上限，这将有效阻止企业获得联邦资金来增加28nm以上芯片的产量。

深圳市科技创新委员会党组书记、主任张林在峰会致辞中表示，2023中国（深圳）集成电路峰会是一个非常契机，要进一步发挥深圳集成电路上游设计领域突出、下游应用场景丰富、创新要素市场化配置程度高的优势，集合各方面资源和力量，全面提升核心技术攻关能力，着力构建安全稳定的产业链条，全方位打造创新之城，把深圳建设成为具有世界影响力的产业创新中心。

在美国信息技术产业委员会（代表英特尔、台积电和三星电子等公司的强大行业组织）公开反对这一决定之后，该规则被撤销。预计所有这三个芯片制造商都将获得联邦政府对在美国境内设立新工厂的激励措施

作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球贸易比较活跃的半导体市场。随着国内各地相继出台了一系列半导体产业扶持政策，中国半导体产业有望在2024年迎来新的机遇和发展空间！深圳国际半导体组委将继续立足市场，整合往届优质资源，优化平台服务，为展商和观众双方合作共赢开辟新空间、谋篇发展新棋局！为半导体产业链上中下游节点的企业搭建出共享、交流、共创的广阔平台，为行业打造了一场“双向奔赴”的采购盛宴。

目前第六届深圳国际半导体的招商工作正在如火如荼地展开，各展区销售进度喜人。还有少量优质展位，预订从速！！

展示范围一、电子元器件展区：无源器件、半导体分立器件/ IGBT 5G核心元器件特种电子、元器件、电源管理、传感器、储存器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、电位器磁性元件、滤波元件、PCB板、电机风扇电声器件、显示器件、二\*\*管、三\*\*管滤波元件、开关及元器件材料及设备等二、IC设计、芯片展区：IC及相关电子产品设计、人工智能芯片、电源管理芯片、物联网芯片、5G通信芯片及方案、汽车电子芯片、安全控制芯片、数模混合通讯射频芯片、存储芯片、LED照明及显示驱动类芯片等三、半导体设备展区：减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、固晶机、等离子清洗设备、切割机、装片机、键合机、焊线机、回流焊、波峰焊、测试机、分选机、耦合机、载带成型机、检测设备、恒温恒湿试验箱、传感器、封装模具、测试治具、精密滑台、步进电机、阀门、探针台、洁净室设备、水处理等四、第三代半导体专区：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件（发光二\*\*管LED、激光器LD、探测器紫外）、电力电子器件（二\*\*管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GTO、ETO、SBD、HEMT等）、微波射频器件（HEMT、MMIC）五、晶圆制造及封装展区：晶圆制造、SiP先进封装、OSATs、EMS、OEMs、IDM、硅晶圆及IC封装载板、印制电路板、封装基板及设备组装和测试等、封装设计、测试、设备与应用制造与封测、EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备六、半导体材料展区：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、晶圆胶带、光掩模版、电子气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料、切片、磨片、抛光片、薄膜等